

江苏亨通光电股份有限公司

关于公司 100Gbps 硅光子模块业务进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司与英国洛克利硅光子公司合作的 100G 硅光子模块项目完成了 100Gbps 硅光芯片的首件试制和可靠性测试，完成了硅光子芯片测试平台搭建。

2017年12月，公司与英国洛克利硅光子公司共同出资，设立江苏亨通洛克利科技有限公司，从事25/100G硅光模块生产销售(详见上海证券交易所网站公告，亨通光电：2017-131)。

截至目前，公司完成了100Gbps硅光芯片的首件试制和可靠性测试，完成硅光子芯片测试平台搭建。具体情况如下：

一、项目组成

100G硅光模块项目包括100Gbps QSFP28有源光缆、100G QSFP28 PSM4光收发模块、100G QSFP28 CWDM4光收发模块三款产品。结合光的极高带宽、超快速率和高抗干扰特性以及微电子技术在大规模集成、低能耗、低成本等方面的优势，解决了以光子和电子为信息载体的硅基大规模光电集成技术运用，将激光器、光探测器、光调制器、波分复用器件、波导、耦合器件等光电子器件“小型化”、“硅片化”并与纳米电子器件相集成，形成一个完整的具有综合功能的新型大规模光电集成芯片。

二、项目进展

项目已经完成100Gbps硅光芯片的首件试制和可靠性测试，完成硅光子芯片测试平台搭建，具体项目包括无源光波导器件的插入损耗、分光比、WDM器件的光谱特性、光探测器的暗电流响应度带宽、光调制器的调制速率消光比眼图、InP基激光器芯片适合于硅光集成的半导体激光器工艺、小发散角大功率脊波导DFB

激光器工艺、高温下激光器散热工艺、激光器与硅波导耦合技术、脊波导激光器应力对可靠性影响。项目进度快于预定时间节点，测试指标均到达、超过预定目标。

三、下一步工作

下一步公司将进行100G硅光子模块的封装、测试及组装工作，预计2018年第四季度完成，2019年实现批量供货。

四、风险提示

下一步公司需进行100G硅光模块的封装、测试及组装等工作，实施具体进度具有不确定性，实施成效存在不确定性，在实施中遇到的困难也具有不确定性。

公司将根据法律、法规、规范性文件的要求，跟踪有关事项进展，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司

董事会

二〇一八年九月四日